

证券代码：301095

证券简称：广立微

杭州广立微电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-003

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会☒路演活动 ☐现场参观☒线上交流 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	南方基金、易方达基金、诺安基金、富国基金、国泰基金、天弘基金、华安基金、宝盈基金、国联安基金、鹏华基金、融通基金、建信基金、建信养老、海富通基金、长盛基金、九泰基金、东方基金、华商基金、国寿安保基金、国投瑞银基金、中银基金、华泰柏瑞、交银施罗德基金、长江养老、长城财富、工银理财、中邮证券、东北证券、广发证券、中信建投、山西证券、国泰海通证券、上海银行、中国人民健康保险股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、光大证券资管、长江资管、统一投信、光大保德、正圆投资、HCEP Management Limited、UBS Asset Management (Hong Kong) Limited、国新投资、农银人寿保险、中国对外经济贸易信托有限公司、灏浚投资、光大永明资产管理公司、润晖投资、CPE 源峰、财通证券资管、上海睿郡资产管理有限公司、杭州中大君悦投资有限公司、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、上海鹤禧私募基金管理有限公司、上海聆泽私募基金管理有限公司、上海煜德投资管理中心（有限合伙）、上海重阳投资管理股份有限公司、深圳前海博普资产管理有限公司、北京君成私募基金管理有限公司、上海中域资产管理中心(有限合伙)、北京鑫乐达投资管理有限公司、江苏瑞华投资控股集团等 62 家

	机构。
时间	2025 年 4 月 23 日-2025 年 6 月 19 日
地点	现场交流、公司会议室
形式	现场会议、线上交流
公司接待人员	董秘兼财务总监：陆春龙 证券事务代表：李妍君
交流内容及具体问答记录	一、公司概况 广立微是领先的集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备供应商，公司专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术，是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。公司现已形成 EDA 设计软件、WAT 测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案，在集成电路从设计到量产的整个产品周期内实现芯片性能、成品率、稳定性的提升。 二、问答环节 1、请公司简要介绍下 2024 年业绩情况 从营业收入来看，得益于公司软件业务的强势发力、快速增长超过 70%，公司整体营收实现双位数增长，年度共计实现收入 54,686.68 万元，同比增长近 15%；在净利润方面，虽然受到营收增速放缓和研发投入大的压力，2024 年度仍然实现了净利润 8,429.98 万元，扣除股份支付的影响公司盈利仍维持在 1 亿元以上。 从毛利率角度，2024 年度的综合毛利率为 61.90%，同比上升 1.77 个百分点，软件业务比例回升至近 30%。分项来看：软件业务毛利率为 85.96%，持续维持在较高水平；硬件业务的毛利率为 52.07%，呈现稳中有升的态势。 研发投入方面，近三年来公司持续加大研发投入，研发费用率一直保持在 30%以上且逐年上升，其中 2024 年度的研发费用收入占比超过了 50%。2024 年度，公司研发投入进一步加大，研发

	费用总额达到 27,656.47 万元，同比增长 33.49%。通过高强度地持续投入，为公司进一步提速发展储备了诸多势能，同时也取得了显著的研发成果，截至 2024 年年末，公司拥有授权专利 179 项，同比增长 38%，其中发明专利 105 项，同比增长 67%。 从财务结构看，2024 年末的股东权益为 314,857.66 万元，资产负债率为 7.57%，仍保持了较低负债率，流动比率为 12.36，保持较高的流动性，也彰显出公司稳健的经营风格。为积极响应“质量回报双提升”行动，公司高度重视股东利益，推出了每 10 股分派股息 2.50 元（含税）的年度利润分配预案，上市以来累计分红将超过 2.17 亿元。 在现金流方面，2024 年度经营活动现金流量净额为 4,690.14 万元，较上年同期增加 122.10%，实现正流入，其中销售商品、提供劳务收到的现金流入超过 5 亿元，较上年同期增长 52.33%。 2025 年一季度公司仍保持较好的增长态势，实现营业收入 6648.49 万元，同比增长 51.43%，净利润亏损规模较去年同期也有所收敛，主要得益于软硬件产品的逐步商务落地。 2、请问公司目前在人工智能领域上布局进展如何？与国内外同行业公司企业相比，是否具备竞争优势？ 公司在人工智能方面的布局已取得显著进展。在产品侧，公司 INF-AI 工业智能化集成平台发布，其中 INF-ADC 自动缺陷分类系统功能迭代，支持多种复杂业务场景，客户数量显著提升；推出 INF-WPA 晶圆缺陷图案分析系统、iCASE 半导体缺陷异常智能化诊断系统，已在客户处部署使用。在大模型侧，公司算法基础能力建设完成，半导体大模型平台 SemiMind 正式推出，深度融合了知识库与智能体大模型技术，目前已引入 DeepSeek、Qwen2 通义千问、GLM-4、MiniCPM 大模型，致力打造开放、灵活、可拓展的智能研发生态系统。未来公司也将推动 AI 技术与更多软硬件产品结合，拓展 AI 在芯片设计自动化、良率提升、软件平台智能化等场景的应用边界，推动半导体行业向更高效
--	--

	率、更低成本的智能化未来迈进。 3、请问对于海外断供 EDA，国产替代加速的背景，公司的发展布局和未来前景如何？ 公司始终秉承自主创新的研发理念，深耕 EDA 领域二十余年，主要布局 EDA 软件及电性测试设备领域。自主研发的良率提升、DFT、DFM 和大数据分析等多款 EDA 软件产品，实现了高质量国产替代，并积极布局核心环节的关键工具研发，加快填补国内市场空白。 海外对华科技遏制既是我国集成电路产业的重大挑战，也为国产 EDA 带来新的发展空间。公司将积极抓住国产替代这一产业变革机遇，加大研发投入，提高技术壁垒，丰富产品矩阵，增强核心竞争力，为我国集成电路事业发展贡献力量。 4、对于公司市值提升、员工股权激励是否有战略安排？ 公司一直高度重视长期投资价值的提升，始终以广大投资者的切身利益为出发点，稳步落实市值管理工作。在业务与经营方面，公司将持续专注主营业务，加大研发投入，丰富产品矩阵，积极进行产业前瞻布局，进一步提升技术壁垒，开拓销售市场，形成新的业绩增长点以保障公司业务的稳步增长和可持续发展。此外，公司将按照相关法律法规及时做好信息披露和投资者关系工作，通过信披公告、公司网站、公众号、互动问答等方式向市场传递公司价值。 2023 年公司推出了限制性股票激励计划，未来也将结合实际发展需要，适时推出符合公司利益、激发员工积极性的股权激励方案。届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。 5、请问公司近期有并购计划吗？重点的并购方向在哪些领域？ 公司自上市以来一直积极关注与公司业务相关领域的发展情况，根据公司总体战略规划，立足自身稳健发展的同时，若有合适的标的，公司将考虑用收购的方式来加速公司成长和发展。并购方向上，主要以公司现有业务为支点，重点关注 EDA 软件、
--	--

	半导体数据软件和测试设备相关的领域。后续如有并购事项，公司将严格按照信息披露要求及时进行公告。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无。
日期	2025 年 6 月 19 日